

公司代码：688135

公司简称：利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司
2025 年半年度报告摘要



第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	利扬芯片	688135	不适用

公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	辜诗涛	陈伟雄
电话	0769-26382738	
办公地址	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号	
电子信箱	ir@leadyo.com	

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用